

Portée détaillée v.6 de l'attestation N° 1-0745

Detailed scope v.6 of the attestation N° 1-0745

Date de publication / Publish date: 10/09/2026

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

THALES SA

THALES - LABORATOIRE D'ANALYSES DES TECHNOLOGIES ET PROCEDES INDUSTRIELS (LATPI)		
ELECTRONIQUE, INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS / COMPOSANTS ELECTRONIQUES, MICROELECTRONIQUES ET LOGICIELS EMBARQUES / Essais de performance ou d'aptitude à la fonction		
Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
1	Composants Si Planar (>90nm), AsGa et GaN hyperfréquence, MEMS Thales Avionics	Méthodes internes: INS023-'LATPI - Réalisation d'une analyse technologique de filière Silicium ou III-V', INS071-'LATPI - Analyse Technologique des composants MEMS Thales'. MILSTD 883 Méthodes 2010, 2013, 2018, 2021 . MILSTD 750 Méthodes 2068, 2071, 2072, 2073, 2074, 2077, 2078 . EN 190000 Guide 2 Annexe G2
2	Boîtiers « plastiques » : DIL, TO(x), (x)SO(x), (x)QFP, QFN, LGA, Isotop, (x)BGA, WLP Cartes imprimées nues et équipées, Composants passifs	Méthodes internes: INS015-'LATPI - Analyse de construction boîtiers plastiques', INS066-'LATPI - Analyse de construction carte imprimée nue', INS067-'LATPI - Analyse de construction des composants passifs', INS069-'LATPI - Analyse de construction carte imprimée équipée', INS024-'LATPI - Analyses matériaux'. MILSTD 883 Méthodes 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2019, 2021, 2023, 2030, 2032 . MILSTD 750 Méthodes 2017, 2037, 2066, 2068, 2076 . AEC Q100-010, PCP-MRD1, IPC A600, IPC A610, Spécification Thales 16 262 704 et 16 262 720, EIA/ECA-469, EIA-595
3	Composants électroniques, Circuits intégrés, Discrets, Passifs, Connecteurs, Capteurs, MEMS, Relais, Batteries, Cartes imprimées nues et équipées	Méthodes internes: INS016-'LATPI - Réalisation des analyses de défaillance', INS071-'LATPI - Analyse Technologique des composants MEMS Thales', INS076-'LATPI - Analyse de pollution'. MILSTD 883 Méthodes 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2023, 2030, 2032 . MILSTD 750 Méthodes 2017, 2037, 2068, 2071, 2072, 2073, 2074, 2076, 2077, 2078 . EN 190000 Guide 2 Annexe G2 IPC A600, IPC A610 Spécification Thales 16 262 720 et 16 262 704 PCP-MRD1 EIA/ECA-469

ELECTRONIQUE, INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS / COMPOSANTS ELECTRONIQUES, MICROELECTRONIQUES ET LOGICIELS EMBARQUES / Essais de performance ou d'aptitude à la fonction

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
4	Composants électroniques et assemblages divers modules, MEMs	Méthode interne: INS021-'LATPI - Analyse de l'intégrité d'assemblages' JEDEC J-STD-020, JEDEC J-STD-035 . MIL STD 883 Méthodes 2012, 2030, 2035, 2019, 2027 . MIL STD 750 méthodes 2076, 2068, 2017, PCP-MRD1, MIL STD 1580 Requirement 16
5	Composants et cartes électroniques, Capteurs	Méthode interne: INS080-'LATPI - Réalisation de tests électriques élémentaires'
6	Composants électroniques, cartes imprimées nues ou équipées, modules, échantillons divers	PCP MRD1, normes MIL STD 883 et 750, Spécification Thales 16 262 720 et 16 262 704, IPC A600 et A610 EIA 595
7	Composants électroniques, cartes imprimées nues ou équipées, modules, échantillons divers	PCP MRD1, IPC A600 et A610, Spécification Thales 16 262 720 et 16 262 704, MIL STD 750 et 883
8	Composants électroniques actifs, passifs et cartes	Méthode interne: INS094-'LATPI - Localisation de défauts'
9	Assemblages divers, composants électroniques, modules, MEMs...	PCP MRD1, J-STD 020 J-STD 035 MIL STD 883 Méthode 2030, MIL STD 1580 Requirement 16
10	Composants électroniques, cartes imprimées nues ou équipées, modules, échantillons divers	PCP MRD1, MIL STD 750 et 883, Spécification Thales 16 262 720 et 16 262 704, IPC A600 et A610, EIA 595 et EIA 469

ELECTRONIQUE, INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS / COMPOSANTS ELECTRONIQUES, MICROELECTRONIQUES ET LOGICIELS EMBARQUES / Essais de performance ou d'aptitude à la fonction

Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
11	Composants, circuits intégrés, cartes imprimées nues ou équipées, modules, échantillons divers, dispositif à semiconducteur	Méthode interne : INS093-'LATPI-Microsection'
12	Boîtiers plastiques de composants électroniques, résines d'enrobage de modules, autres échantillons divers	Méthode interne : INS092- 'LATPI - Ouverture de composants'
13	Composants électroniques, cartes imprimées nues ou équipées, modules, échantillons divers	MIL STD 750 et 883, PCP MRD1, Spécification Thales 16 262 720 et 16 262 704 IPC A600 et A610
14	Matériaux divers (organiques, organo-métalliques, produits de corrosion, inorganiques...)	Méthode interne: MO192-'LATPI - Utilisation du microscope FTIR IN10
15	Microsoudures utilisées pour le câblage filaire en électronique (balls, wedges); puces, capacités céramiques, CMS, composants divers, billes (de composant BGA)	MIL STD 883 méthode 2011 ou 750 méthode 2037 PCP MRD1, MIL STD 883 méthode 2019, AECQ100-010
16	Cartes imprimées nues ou équipées	Spécification Thales 16 262 720
17	Cartes imprimées nues, composants électroniques, composants divers	Spécification Thales 16 262 720, IPC A600
18	Puces électroniques avec passivation de surface et métallisation Aluminium	MIL STD 883 méthode 2021-procédure A

ELECTRONIQUE, INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS / COMPOSANTS ELECTRONIQUES, MICROELECTRONIQUES ET LOGICIELS EMBARQUES / Essais de performance ou d'aptitude à la fonction		
Référence portée générale <i>Flexible scope reference</i>	Objet <i>Object</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>
19	Dispositif à semiconducteur	Méthode interne: MO048-'LATPI - Réalisation d'effeuillage face avant et face arrière sur composants Si, SiGe et GaAs, GaN'
20	Dispositif à semiconducteur	Méthodes internes: MO010-'LATPI - Révélation des microsections', MO065-'LATPI - Révélations chimiques des caissons et zones actives sur puce silicium entièrement déprocessée'